

公司概況資料表

以下資料由創新服務股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：創新服務股份有限公司 (股票代號：7828)

董事長	吳智孟
總經理	吳智孟
資本額	新臺幣362,799,110元
輔導推薦證券商	凱基證券股份有限公司、福邦證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	凱基證券股份有限公司 顏小姐(02)2181-8888#8108
註冊地國	不適用
訴訟及非訟代理人	不適用

輔導推薦證券商認購創新服務股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦
	凱基證券股份有限公司	福邦證券股份有限公司
認購日期	114年4月25日	
認購股數(股)	989,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	2.73%	0.28%
認購價格	每股新臺幣220元	
認購價格之訂定依據及方式	<p>本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，評估市價法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購創新服務股份有限公司(以下簡稱創新服務或該公司)興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司所處產業前景、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。</p> <p>基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺</p>	

點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

一、市價法：本益比法(Price/Earnings ratio, P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio, P/B ratio)，均透過已公開的資訊與整體市場、產業性質相近之同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業之價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整。

二、成本法：以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。

三、現金流量折現法：以未來現金流量作為公司價值評定基礎。

以上股票評價方法：成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或產業成熟但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商主要採用本益比法作為評估基準。

創新服務為精密半導體自動化設備研發、製造及銷售之專業廠商，主要產品為探針卡相關設備整體解決方案(含自動植針機、精密雷射鑽孔設備、Probe Card 檢測設備及探針修復設備等)、Pogo Pin 自動植針機及精密雷射返修設備，客戶涵括國際知名探針卡製造廠、封裝/測試廠、LED 製造廠及晶圓代工廠等。

綜觀目前國內上市櫃公司尚無業務內容與該公司完全相同者，考量營運規模、所屬產業上下游關聯性及產品應用領域後，選擇採樣同業為上市公司牧德科技股份有限公司(以下簡稱牧德，股票代碼：3563)，主要從事機械視覺(Machine Vision)檢測及量測系統設備等開發製造業務；上市公司穎歲科技股份有限公司(以下簡稱穎歲，股票代碼：6515)，主要從事半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組等開發製造業務；上櫃公司旺矽科技股份有限公司(以下簡稱旺矽，股票代碼：6223)，主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務；上櫃公司中華精測科技股份有限公司(以下簡稱精測，股票代碼：6510)，主要從事介面板之測試服務，包含晶圓測試板及 IC 測試板之研發設計、技術諮詢服務與產製。茲將上述採樣同業及上市(櫃)半導體類股最近三個月(113年12月~114年2月)之本益比列示如下：

單位：倍

採樣同業	本益比			
	113年12月	114年1月	114年2月	平均
牧德(3563)(註)	71.74	67.93	78.80	72.83
穎歲(6515)(註)	33.37	35.70	40.08	36.38
旺矽(6223)(註)	37.92	36.08	31.98	35.33
精測(6510)(註)	56.72	51.96	49.52	52.73
上市半導體類股	26.20	27.43	23.43	25.69
上櫃半導體類股	27.50	27.20	29.01	27.90

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心；凱基

修訂日期：113年7月

	<p>證券整理。</p> <p>註：本益比以經會計師查核簽證之113年度財務報告每股盈餘進行計算。</p> <p>經參考該公司採樣同業、上市半導體業類股及上櫃半導體業類股最近三個月(113年12月~114年2月)平均本益比，由於上市半導體類股及上櫃半導體類股本益比顯著低於採樣同業，故擬不予採用。經計算其採樣同業平均本益比區間落在35.33倍~72.83倍之間，另以該公司113年度經會計師查核簽證之財務報告稅後淨利149,887千元及截至目前為止已發行股份總數36,280千股計算之每股盈餘4.13元為設算基礎，按上述本益比區間計算其參考價格約為146~301元，另參酌該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性及考量興櫃流動性風險後，以八折設算後參考認購價格區間為117~241元，本主辦輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股220元，介於上述參考價格區間，應尚屬合理。</p>
--	---

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

創新服務股份有限公司成立於民國93年，為精密半導體自動化設備研發、製造及銷售之專業廠商，產品涵蓋探針卡相關設備整體解決方案(含自動植針機、精密雷射鑽孔設備、Probe Card 檢測設備、探針修復設備...)、Pogo Pin 自動植針機、精密雷射返修設備...等。

創新服務累積逾20年半導體先進測試及光電領域自動化設備設計、製造及生產經驗，擁有完整的研發團隊，涵蓋精密機械、自動化科技、材料、軟體硬體、電子、資訊、光電等全方位的技术整合能力與自有關鍵技術，根據客戶需求量身打造解決方案，滿足客戶對各類高效能自動化設備之需求。

二、歷史沿革

年度	重要紀事
民國 93 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 創新服務股份有限公司成立，於台中大甲設立工廠，資本額新台幣 8,000 仟元。 ● 推出第一代塑膠剪切機。
民國 94 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出單站式鏡頭組裝機。
民國 97 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出光學觸控屏校正設備。
民國 98 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出第一代多鏡片鏡頭自動組裝機。
民國 100 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出伺服刀座鏡片澆口自動剪切機。 ● 推出耐熱鏡片(Reflow Lens)自動組裝點膠設備。
民國 101 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出高階鏡頭自動組裝機。
民國 103 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 切入半導體先進測試製程，開發半導體晶圓級測試 MEMS(微機電)探針卡自動植針設備。 ● 通過 ISO 9001 品質認證。
民國 104 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 推出全球第一台半導體晶圓級測試 MEMS(微機電)探針卡自動植針設備。
民國 105 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得半導體晶圓國際大廠 MEMS 探針卡自動植針獨家代工業務。
民國 106 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 開發蛇型(Cobra)自動植針設備。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 開發彈簧針(Pogo Pin)自動植針&電性(FDR, Force Distance Resistance)量測設備。
民國 107 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得半導體設備設計、製造、銷售之 ISO9001 證書。 ● 推出半導體 Probe Card MEMS 探針微整列模組。 ● 開發 MEMS 探針移轉及檢測自動修復設備。 ● 開發五軸飛秒雷射鑽孔機。
民國 108 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 中國子公司上海創崑醫療器材有限公司成立。 ● 推出 Mini LED 自動化電測雷射修復及燈板自動化電測設備。
民國 109 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 獲准入駐新竹科學園區。 ● 開發精密飛秒雷射切割設備。
民國 110 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 開發先進封裝製程-銅柱巨量移轉模組。 ● 開發皮秒雷射精密加工設備。 ● 除代工 MEMS 探針卡自動植針業務外，開始全面銷售自動植針設備。
民國 111 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 開發先進封裝製程-銅柱巨量移轉設備。
民國 112 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 開發新世代高效 Dual Arm MEMS Arm Probe Card 自動植針設備。
民國 113 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資 60,000 仟元，實收資本額 276,670 仟元。 ● 推出先進封裝高密度銅柱端子模組。 ● 開發 MEMS 探針卡 Probe Card 整體自動化維修解決方案。
民國 114 年	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資 62,799 仟元，實收資本額 362,799 仟元。 ● 開發先進封裝銅柱 TGV 基板自動化製造解決方案。

三、經營理念

該公司持續秉持「研發創新、服務客群」的經營理念，戮力開創自有品牌價值，配合國內外客戶進行專業製程創新、開發創新智慧化設備並提供代工服務，共同打造台灣自動化競爭力、開創高值化智能設備產業產值。

四、未來展望

(一)短期業務發展計畫

- 1.持續投入製程技術和核心設備的開發上，保持技術領先地位。
- 2.透過與國際大廠客戶合作，提供客製化之完整性解決方案，以推動公司技術升級及擴增設備市場廣度。

(二)中、長期業務發展計畫

- 1.建立技術獎勵機制，鼓勵員工創新，並進行智慧財產權的策略佈局，保護公司研發成果。
- 2.與供應商建立長期夥伴關係，集中採購以提高零件品質和供應穩定性。
- 3.擴充產線及增聘員工，提升產能及增加所能提供之設備與服務多樣性，以因應客戶端逐步增加的訂單需求。

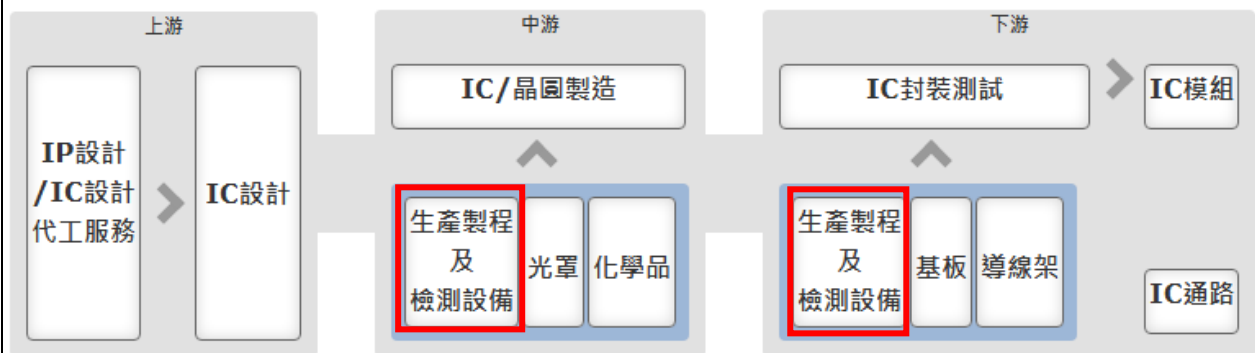
[TOP ^](#)

主要業務項目：



主要係從事精密半導體自動化設備之研發、製造及銷售，產品涵蓋探針卡相關設備整體解決方案(含自動植針機、精密雷射鑽孔設備、Probe Card 檢測設備、探針修復設備…)、Pogo Pin 自動植針機、精密雷射返修設備...等。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

該公司擁有完整的研發團隊，涵蓋精密機械、自動化科技、材料、軟體硬體、電子、資訊及光電等全方位的技术整合能力，可根據客戶需求量身打造解決方案，從影像處理到設備整機優化及整線自動化方案，滿足半導體客戶對各類高效能自動化設備之需求，成為精密半導體自動化設備整體解決方案提供者，屬於中游及下游之半導體製造設備廠商。



資料來源：櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
精密半導體 自動化設備	 	該公司目前營收比重最高之產品為自動化植針設備，隨著半導體先進製程的演進，半導體探針卡(Probe Card)及測試治具(Test Socket)朝 Pin count 數快速增加，且間距持續微小化發展，傳統人工植針方式已難以勝任，透過自動化植針設備可大幅提升植針效率、準確度及穩定性。	378,422	93.20
其他	—	植針代工、雷射代工、零件銷售及技術服務等	27,595	6.80
合計			406,017	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年	110年	111年	112年	113年	114年截至3月份止 (自結數)(註1)
營業收入		202,415	286,776	163,879	120,383	406,017	100,286
營業毛利		165,503	236,505	139,563	74,408	325,867	61,980
毛利率(%)		81.76	82.47	85.16	61.81	80.26	61.80
營業損益		62,247	100,068	6,927	(54,918)	150,508	15,478
營業外收支		(1,966)	(4,510)	286	3,559	16,607	7,664
稅前損益		60,281	95,558	7,213	(51,359)	167,115	23,142
稅後損益		46,828	82,035	8,341	(49,934)	149,887	18,513
每股盈餘(元)		4.36	4.11	0.40	(2.33)	5.25	0.51
發放	現金股利(元)	0.81	1.38	0.36	—	1.50(註3)	—
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	3.26	—	—	—	—	—
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	—	4.00	—	—	—	—

註1：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

註2：109~113年度係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編製。

註3：尚待股東會決議。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

年度		109年	110年	111年	112年	113年
項目						
流動資產		143,805	293,343	270,195	321,049	728,130
不動產、廠房及設備		92,939	82,216	103,765	144,627	130,145
無形資產		2,050	6,717	5,862	3,593	1,276
其他資產		22,603	19,837	19,323	16,246	28,965
資產總額		261,397	402,113	399,145	485,515	888,516
流動負債	分配前	85,881	83,777	97,597	86,817	248,201
	分配後	90,601	92,937	118,297	94,427	248,201
長期負債		13,925	9,641	4,006	1,094	13,280
負債總額	分配前	99,806	93,418	101,603	87,911	261,481
	分配後	104,526	102,578	122,303	95,521	261,481
股本		76,241	150,000	210,000	276,670	348,094
資本公積		12,006	49,384	51,207	142,172	129,031
保留盈餘	分配前	73,346	108,700	36,372	(21,172)	149,887
	分配後	68,626	99,540	15,672	(28,782)	149,887
其他權益		(2)	611	(37)	(66)	23
股東權益總額	分配前	161,591	308,695	297,542	397,604	627,035
	分配後	156,871	299,535	276,842	389,994	627,035

註：109~113年度係經會計師查核簽證之財務報告並採用國際財務報導準則編製。

TOP^

最近三年度財務比率

年度		111年	112年	113年
項目				
財務比率	毛利率(%)	85.16	61.81	80.26
	流動比率(%)	276.85	369.80	293.36
	應收帳款天數(天)	210.57	37.28	23.15
	存貨週轉天數(天)	942.09	472.47	247.00
	負債比率(%)	25.46	18.11	29.43

TOP^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)

修訂日期：113年7月